

適用規格					
定格	使用温度範囲	-35℃～ +85℃ (注1)	保存温度範囲	-10℃～ +60℃ (注3)	
	使用湿度範囲	40%～ 80% (注2)	保存湿度範囲	40%～ 70% (注3)	
	電圧	AC 250V		適合コネクタ	DF1B-*DS-2.5RC
	電流	AWG20～24: 3A AWG26: 2A AWG28: 1A AWG30: 0.5A			

性能

	項目	試験方法	規格	QT	AT
構造	外觀, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
電氣的性能	接触抵抗	100 mA (DC又は 1000 Hz) で測定する。	30 mΩ以下	○	—
	絶縁抵抗	DC 500 Vで測定する。	1000 MΩ以上	○	—
	耐電圧	AC 650 Vの電圧を 1 分間印加する。	せん絡・絶縁破壊がないこと。	○	—
機械的性能	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。	①接触抵抗: 30mΩ以下 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz, 片振幅 0.75 mmで 3 方向 各 2 時間試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² , 持続時間 11 ms, 正弦半波 3 方向 各 3 回試験する。	①1μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ②破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
環境的性能	定常状態の耐湿性	温度 +40 ± 2℃, 湿度 90～95 %中に 96 時間放置する。	①接触抵抗: 30mΩ以下 ②絶縁抵抗: 1000MΩ以上 ③破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	温度サイクル	温度 -55 → +5～+35 → +85 → +5～+35℃ 時間 30 → 5以内 → 30 → 5以内分 を 5 サイクル 試験する。	①接触抵抗: 30mΩ以下 ②絶縁抵抗: 1000MΩ以上 ③破損, ひび, 部品のゆるみがないこと。	○	—
	半田耐熱性	【フローはんだ付けの場合】 はんだ温度260℃, 浸漬時間5秒間のはんだ付けを行う。 【手はんだ付けの場合】 はんだごてで300℃, 3秒の条件にて はんだ付けを行う。 但し, 端子に力を加えないこと。	外觀の変形及び端子等に 著しいガタがないこと。	○	—
	半田付け性	半田温度 235℃, 浸漬時間 5秒間 の半田付けを行なう。	半田浸漬面の 95 %以上が 新しい半田で濡れていること。	○	—

備考

- (注1) 通電時の温度上昇を含みます。
 (注2) 結露がないこと。
 (注3) 基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用。
 基板搭載後、輸送時の一時保管は使用温湿度範囲を適用。

△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△	DIS-H-002406	YK. NAKATSU	HK. UMEHARA	07. 08. 30
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。			承認	TY. OMA
			検図	HK. UMEHARA
			担当	AH. MIYAZAKI
			製図	AK. MIURA
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目		図番	SLC4-071801-09	
HRS	製品規格表		製品名	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	
		DF1B-*DP-2.5DS(01)		
		CL541		△ 1/1